

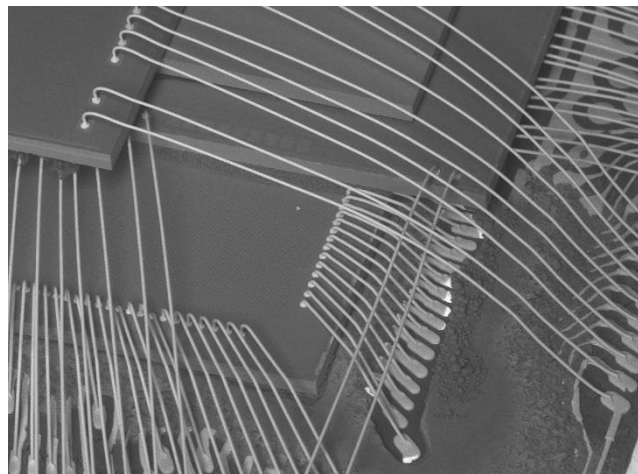
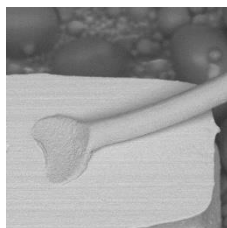
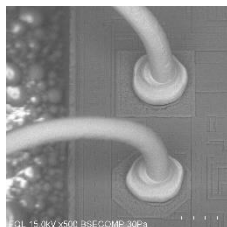
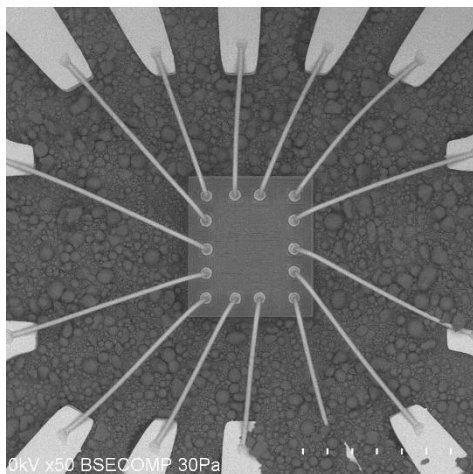
## 故障解析事例（Cuワイヤ使用ICのパッケージ開封）

### 概要

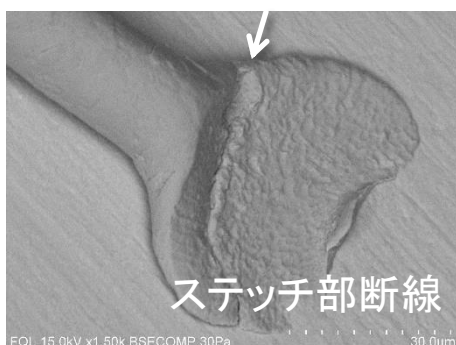
半導体部品の低コスト化に伴い、AuからCuワイヤへの移行が加速しています。  
難点は、既存のパッケージ開封方法では樹脂と共にCuワイヤも溶解され、後の調査に支障が出る点であり、IC形状や内容に合わせダメージを抑えた手法が求められます。

### 特徴

ワイヤ表面の観察、ボンディング問題の確認、エミッション観察の通電など、故障解析の目的に合わせたパッケージ開封を行います。



\* 開封後のCuワイヤの状態は、樹脂種、ワイヤ種、形状等により 程度が異なりますので、事前トライアルをお勧めしております。



お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く